

## 出展のご案内

Booth No. **3533**

### FOWLP, PLP, TSVウェーハの研削 ～半導体及び先端パッケージ技術の進化への対応～

FOWLP/PLP研削におけるCu+モールド樹脂加工  
及び複合材平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

**加工実例** 積層技術に対応した、パッケージ材料、TSVウェーハ  
様々な樹脂・金属・膜の複合素材



#### 5G関連

LT/LN等の電子部品の  
研削・CMP装置

### 次世代材料向けCMP/ パッケージ基板薄化を 総合砥粒加工を提案します

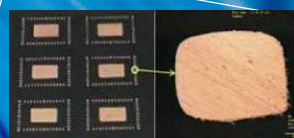
「技術の岡本」をスローガンに、  
総合砥粒加工機メーカーとして  
5つのご提案を致します。



Before Grinding



After Grinding



Cu/Mold Grinding with HPD



Si/Mold Grinding with HPD

#### 次世代ウェーハ材料用CMP

最先端・高精度SOI、InP、GaAs、  
Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等に対応したCMP装置

#### bumpsウェーハの薄化

BGテープの高精度研削技術

#### 次世代 パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、  
高速加工技術と装置